

国机精工集团股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2026—032

投资者关系 活动类别	☒ 特定对象调研 ☐ 分析师会议 ☐ 媒体采访 ☐ 业绩说明会 ☐ 新闻发布会 ☐ 路演活动 ☐ 现场参观 ☐ 电话会议 ☐ 其他
参与单位名称 及人员姓名	国寿资产：孙旭鹏 浙商证券：秦乐恒 东北证券：赵宇阳、邵怡、王若桐、万陈鹏、赵宇天 景顺长城：吴泽煌 五矿信托：康乐 广发证券：石恺 上海银叶：刘欢宇 上海兆顺：张琦佳 歌汝资产：武子皓
时间	2026 年 9 月 7 日
地点	国机精工下属企业郑州磨料磨具磨削研究所有限公司
上市公司接待 人员姓名	董事会秘书：赵祥功 董事会办公室主任：赵金伟 投资者关系助理：汪智婷
投资者关系活 动主要内容介 绍	1. 问：超硬材料磨具业务开展情况如何？ 答：2026 年上半年，超硬磨具业务收入 3.72 亿元左右，下游应用分半导体领域和非半导体（汽车、制冷、LED、工模具等）领域。其中用于半导体领域的产品近几年增长较为显著，上半年同比增速约 40%。公司超硬材料磨具产品性能优越，具有较高的技术门槛，竞争对手基本为国际跨国企业。 2. 问：超硬材料磨具业务在半导体领域的开展情况？ 答：近几年，得益于我国半导体产业的发展，公司应用在半导体领域的产品保持较快增长势头。产品种类上，金刚石工具类已覆盖倒边轮、减薄砂轮、划片刀、封装刀等产品类型，精密陶瓷制品类已覆盖陶瓷载盘、陶瓷吸盘、真空卡盘、静电卡盘等产品类型。

3. 问：公司精密陶瓷制品业务的情况？

答：公司在半导体领域精密陶瓷产品上处于行业领先地位，该类产品包括陶瓷载盘、陶瓷吸盘、真空卡盘、静电卡盘等。应用在半导体领域的精密陶瓷制品，技术开发难度大，产品技术壁垒较高，市场前景好，是公司未来几年重点推广的产品，公司将加快其市场导入，持续提升市场占有率。

4. 问：公司半导体耗材的客户结构如何？

答：公司半导体客户按产品类型分布较清晰。金刚石工具对应的客户集中于封装领域，精密陶瓷制品客户以半导体设备厂为主。

5. 问：金刚石散热主流产品类型及市场如何比较？

答：行业内主流产品分为单晶金刚石散热片、多晶金刚石散热片和金刚石铜复合材料三大类。单晶金刚石散热片热导率约 $2000\text{W/m}\cdot\text{K}$ 以上；多晶金刚石散热片的热导率约 $1500\text{W/m}\cdot\text{K}$ ；金刚石铜复合材料热导率约 $800\text{W/m}\cdot\text{K}$ 。市场主要从生产成本、生产工艺、下游适配场景等维度综合评估。

6. 问：公司在金刚石散热领域的产品布局和进展？

答：目前，金刚石散热片和金刚石光学窗口片已有小批量订单，主要供应国防工业领域，2025 年实现收入超 1000 万元。

在散热领域，公司已形成覆盖金刚石单晶、金刚石多晶及金刚石铜复合材料的产品矩阵。产业化进展方面，CVD 金刚石产品（含单晶与多晶）已进入行业头部客户的验证阶段；金刚石铜复合材料已向重点客户送样验证。在民用散热领域，各技术路线产品目前均处于下游客户验证阶段，如果进展顺利，年内有望有小批量订单的商业化落地。

7. 问：金刚石散热实现产业落地的核心制约因素有哪些？

答：主要受成本约束，与传统散热材料相比，金刚石散热材料的成本较高，在传统散热材料能够解决散热问题的场景，基本不会采用金刚石散热方案。目前情况看，随着高性能芯片的进一步发展，传统散热材料的性能局限逐渐显现，在此背景下，金刚石散热材料有望在未来成为高性能芯片的必选散热材料。

8. 问：公司在商业航天轴承的业务优势如何？

答：公司在航天领域具有很强的竞争力，且因航天轴承应用工况特殊、技术壁垒和市场门槛高，对可靠性要求高，短期内竞争相对有序，但长期来看不排除竞争加剧的情形。

关于本次活动是否涉及应披露重大信息的说明	否
活动过程中所使用的演示文稿、提供的文档等附件（如有，可作为附件）	无